

江苏长电科技股份有限公司

2022 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日（星期四）15:30-17:30 通过进门财经以电话会议和网络文字互动的方式召开了 2022 年第三季度业绩说明会，就公司 2022 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行了交流和沟通。现将召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上披露了《江苏长电科技股份有限公司关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2022-063）。

2022 年 11 月 17 日（星期四）15:30-17:30，公司首席执行官（CEO）郑力先生、董事会秘书吴宏鲲先生、财务副总裁谈征先生等相关人员就公司 2022 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与近 400 位机构及个人投资者进行了交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、一些晶圆厂也在布局先进封装，管理层怎么看未来先进封装这个市场的竞争格局，和晶圆厂相比，公司在先进封装的优势在哪？

回复：IDM 公司的封装、Foundry 的封装、OSAT 的封装长期在行业中并存，不是新业务模式，客户会根据不同的产品特性，业务模式选择不同的供应链模式。基于可持续业务发展需求，中大规模客户也会采用双供应商采购供应模式。中长期看，产业分工越来越明显，设计和 IDM 会把更大的投资放在产品开发上，把

晶圆制造和封测越来越多的依靠专业生产制造工厂。先进封装随着 Chiplet 异构集成技术的发展，晶圆厂和封测企业的合作和分工越来越为重要。2.5D、3D 封装所需的晶圆内部的加工如 TSV 加工，硅转接板加工等工序属于晶圆厂制程的擅长，而晶圆，裸芯片(Die)之间的高密度互联和堆叠，以及和基板，接点的互联技术属于芯片后道成品制造环节的优势。正如 IDM 厂在先进技术先进产品上越来越依靠和晶圆厂，OSAT 厂的深度合作一样，在以 Chiplet 为代表的先进封装业务的发展过程中，晶圆厂和芯片后道成品制造厂之间的合作在客户的推动和支持下会更加紧密，形成良性互补，共同突破后摩尔定律时代集成电路技术进步的物理极限。

2、目前长电科技投资的 100 亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目，及年产 36 亿颗高密度集成电路及系统级封装模块目前产能如何，接下来的资本支出能否跟上公司的战略布局，如何面对目前台积电等芯片制造企业布局高性能封装行业的挑战？

回复：公司 2021 年非公发募投项目中，年产 100 亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目已开始生产，年产 36 亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目已开始小批量试生产，但由于疫情反复的影响及国内通讯消费端市场存货调整带来的下行压力比原先规划有所放缓，具体达产进度及实施计划将视客户实际需求而定。公司在过去两年通过持续的盈利和资产结构的改善，现金流能力显著提升，资产负债率下降，打好了发展基础。行业下行反而是公司发挥自身基础优势扩大投资和调整产能结构的机遇。一方面下行周期设备交期明显改善，另一方面可以让公司更好的判断逆周期的需求方面，公司可借此机遇扩大投资，逐步调整产品结构，加速从消费类向市场需求快速增长的汽车电子，5G 通信，高性能计算、存储等高附加值市场的战略布局，补充产能和业务短板，并平滑半导体周期波动带来的影响，积极满足客户对长电科技的中长期产能需求。

3、公司的 XDFOI 方案相比其他通过 TSV 的方案，在技术和成本上有什么优势吗？

回复：我们 XDFOI™技术平台，既有 TSV less，也有 TSV 方案，根据客户的不同需求，可以提供完整灵活的方案。

4、公司明年在国内和海外扩产的策略、以及投入比例。

回复：公司未来产能扩充将紧跟客户需求，以满足客户对长电科技中长期的产能需求。公司充分受益于国内外双循环的市场发展，未来在国内的扩产以满足国内外客户针对国内市场的需求为主，海外工厂的扩产以满足国内外客户针对海外市场需求的产能布局要求为主。目前公司海外工厂收入贡献接近 2/3，国内客户对于高性能封装的需求也在逐渐增长，公司将根据国内客户的需求逐步加速高性能封装在国内外的扩产。另外公司持续推进产能结构调整，已持续加大在 5G 通信，高性能运算，汽车电子，和高性能存储领域的产能扩张，积极投入到先进封装和高端测试领域，尤其在汽车电子行业补足公司产能短板和在 chiplet 技术领域，紧跟市场和需求，抓住新技术客户量产机遇。通过持续聚焦在高附加值和高门槛领域，推动公司收入结构的优化。

5、chiplet 技术在设计方和封测方的侧重点有何不同？哪方的贡献度大？需要相互配合吗？

回复：Chiplet 技术要求设计公司和封测厂有更加紧密的协同设计合作。公司去年成立的设计服务事业部，协助和承接面向设计公司对 chiplet 产品的新的设计要求。公司于今年 11 月完成向全资子公司长电科技管理有限公司增资至 10 亿元人民币，有助加速了长电科技上海创新中心验证线建设，此举即进一步强化了公司在上海的先端技术领域创新技术和产品研发能力，加速实现 chiplet 产业链协同设计、供应链联合创新的能力。公司将逐渐发挥 XDFOI™技术平台的多样性优势，未来公司将与国内外产业链共同合作，大力研发和布局 interposer, silicon bridge 和 Hybrid bonding 技术方案，其中在 interposer 领域与晶圆厂合作为客户提供高效可靠的芯片到 interposer 和 interposer 到基板的互联；而对于互联密度要求更高的客户提供 silicon bridge 和 Hybrid bonding 的技术及产能支持。

6、考虑到行业的竞争格局，明年是否在价格侧有压力，公司的策略会是怎样？

回复：在国内消费类市场疲软的情况下，对于技术门槛比较低的传统封装这一类领域，价格压力比较明显。这些年来长电科技通过跟国际领先的客户的合作

当中，越来越倾向于像高性能的大尺寸高精度的这样的芯片的封装投入。我们这三年来一直提出来资本开支要有针对性，避免同质性的竞争，是要通过我们在技术上的核心竞争力，通过我们在全球市场和头部客户磨练出来的工艺技术的核心竞争力，实现差异化的趋势。

所以我们觉得在传统领域的这个价格的压力，并不会对我们在高性能芯片上面的价值的提升产生明显的不良影响。反而包括我们国内的客户，都在向高端的芯片转型，这一块恰恰也是长电科技希望加大和国内客户来合作的重要的领域。所以总体来说通过我们产品组合的不断优化，公司整体的混合单价的 ASP 还是呈现一个上涨趋势。这也是一个指标来验证我们通过产品组合的优化来提升附加价值这样一个发展的方向。

7、公司对半导体周期的展望，特别是对国内通讯及消费类客户库存水平的看法，目前已经到了什么阶段？

回复：对于整个半导体每过四五年都有这样的一轮周期，半导体行业也已经比较熟悉了这样的一个周期的变化。我们看到消费类市场国内客户的需求确实还没有完全恢复过来，但是在某些细分领域当中，特别是在产品复杂度比较高，技术门槛相对高的一些领域，一些客户包括手机类客户，它的库存调整已经出现了比较积极的这个拐点的信号，这个拐点的信号，比我们原来预期的还要再快一些。所以可以看出来，确实是一些有技术基础的客户，它的转型能力也是比较快。比如说面向这个手机里边的原来相对单纯的一些 PA 类的产品。那么这个水平比较高的客户，他就很快的可以转型到集成度比较高的，附加价值比较高的这样的产品上来。这个我想对于这些客户整体的产品结构和库存水平能够得到尽快的改善，确实起到了比较好的作用。

我们也是在瞄准在这些客户他在面向这个周期变化当中，产品转得比较快的这个客户加大支持，在它的下一条产品发展的曲线通过我们共同的努力，可以在大周期下降时，同时发现更好的上升的曲线，实现产业链上的共赢。

8、公司今年全年资本开支是怎样的展望？2023 年资本开支和今年相比重心或结构会有哪些差异？

回复：2022 年公司计划资本开支 60 亿，较 2021 年大幅增加测试相关产能投入，占比较往年有显著提升。目前公司全年的资本开支计划并未调整，维持年初的计划，该计划属于今年立项的对外投资项目，现金支付往往会持续多个季度或者跨年，不代表今年的现金资本支出为 60 亿。目前为止公司下单（包括审批及计划下单）的设备订单符合公司的计划节奏。另外今年由于基建项目占资本开支增加，同时部分设备交期延长，公司根据付款条件延长部分付款账期，将使得现金资本支出小于 60 亿。明年的资本支出计划尚在制定过程中，公司一般会于年初披露相关计划。从中长期的角度来看，公司看好整个行业发展的前景，同时也会抓住相应的高潜力的发展的机遇增加投入，以满足国内外客户对于长电科技的一个中长期产能的需求。

9、中国很多设计企业自建测试产线，对封测企业的中长期影响？

回复：这几年来中国大陆芯片设计公司随着规模的扩大，也希望在测试这个领域能够有自己的一些特色，包括对自己的核心技术出于保密的理由，要设置一些在测试领域的这个生产或者基材的投资。其实这个趋势这么多年不管是从日韩、欧美还有台湾的设计公司来看，在早期也有很多企业是这样做，但是随着企业的规模的进一步扩大，随着他们对自己的这个产品的测试程序测试手法有了进一步的专业化的这个提升，以后越来越多的国际上的领先的企业会再次把它的测试或 Turnkey 业务交给 OSAT 去做。因为从大批量的封测产品看，代工模式的效率更高，具有更好的规模效应。我们看到随着客户相关工艺成熟和规模的上升，将越发依赖专业的封测代工企业为其提供全方位封装测试服务。这也是公司主要测试客户为海外大型 IC 设计，IDM 和终端厂商的原因。中长期看，产业分工越来越明显，设计和 IDM 会把更大的投资放在产品开发上，而晶圆制造和封测越来越多的依靠专业生产制造工厂。

所以在未来我们看到特别是对于芯片越来越复杂，或者是说设计公司它的规模变得越来越大，需要更加先进的测试系统和能力，测试和仿真也在整个高精密封装环节中扮演重要角色。公司看好测试市场的发展机会，所以我们也愿

意在测试领域根据客户的需求进一步的加大我们的测试投入。公司今年在测试领域的资本开支较去年显著提升，引入更多的 5G 射频，汽车芯片，高性能计算芯片的测试业务，支持我们测试业务的快速发展。今年 3 季度公司测试领域收入增长进一步加速，同比增长接近 30%。

关于本次业绩说明会的具体内容，详见进门财经 APP/进门财经小程序，搜索“600584”进入“长电科技（600584）2022 年第三季度业绩说明会”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容；也可在上证 e 互动平台“上市公司发布”查看本次业绩说明会记录。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十八日